

证券代码：002185

证券简称：华天科技

公告编号：2013-010

## 天水华天科技股份有限公司 2012 年度报告摘要

### 1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

#### 公司简介

|          |                   |              |        |
|----------|-------------------|--------------|--------|
| 股票简称     | 华天科技              | 股票代码         | 002185 |
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所           |              |        |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书             | 证券事务代表       |        |
| 姓名       | 常文瑛               | 杨彩萍          |        |
| 电话       | 0938-8631816      | 0938-8631990 |        |
| 传真       | 0938-8630216      | 0938-8632260 |        |
| 电子信箱     | htcwy2000@163.com | ycp@tsht.com |        |

### 2、主要财务数据和股东变化

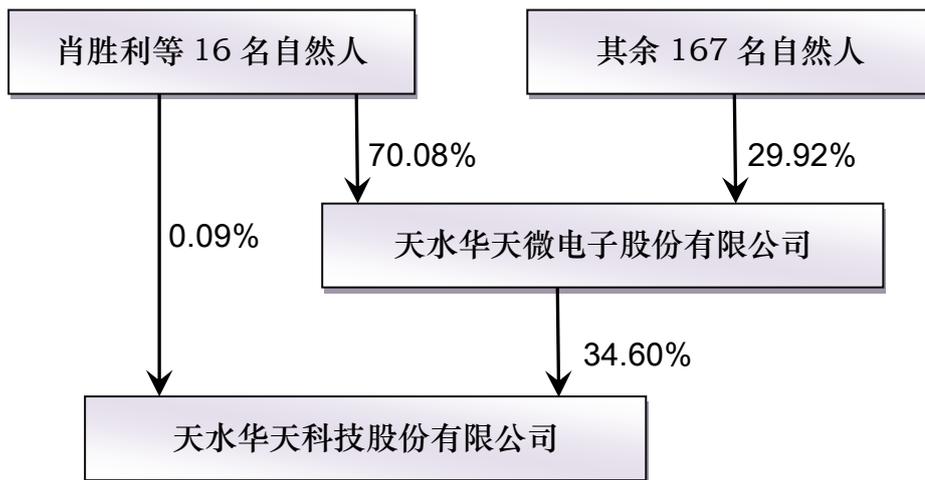
#### (1) 主要财务数据

|                           | 2012 年           | 2011 年           | 本年比上年增减(%)   | 2010 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入(元)                   | 1,623,202,273.50 | 1,308,920,880.27 | 24.01%       | 1,161,237,632.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 121,035,150.15   | 78,956,088.94    | 53.29%       | 111,871,226.26   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 70,153,712.98    | 47,742,280.40    | 46.94%       | 104,922,334.69   |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | 214,506,255.89   | 218,474,741.88   | -1.82%       | 292,492,802.70   |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.1863           | 0.1303           | 42.98%       | 0.1873           |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.1863           | 0.1303           | 42.98%       | 0.1873           |
| 加权平均净资产收益率(%)             | 8.16%            | 7.1%             | 1.06%        | 11.61%           |
|                           | 2012 年末          | 2011 年末          | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末          |
| 总资产(元)                    | 2,555,439,760.21 | 2,307,030,104.16 | 10.77%       | 1,741,504,924.80 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 1,523,632,824.47 | 1,443,210,674.32 | 5.57%        | 1,013,736,585.38 |

(2) 前 10 名股东持股情况表

| 报告期股东总数           | 42,531  | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 45,322      |              |         |            |
|-------------------|---|-----------------------|-------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名股东持股情况      |   |                       |             |              |         |            |
| 股东名称              | 股东性质  | 持股比例 (%)              | 持股数量        | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |            |
|                   |   |                       |             |              | 股份状态    | 数量         |
| 天水华天微电子股份有限公司     | 境内非国有法人   | 34.6%                 | 224,827,520 | 0            | 质押      | 46,000,000 |
| 杭州友旺电子有限公司        | 境内非国有法人   | 4.95%                 | 32,180,000  | 0            |         |            |
| 施玉庆               | 境内自然人   | 1.85%                 | 12,030,000  | 0            |         |            |
| 宁波市鄞州齐智投资顾问有限公司   | 境内非国有法人   | 1.77%                 | 11,520,000  | 0            |         |            |
| 上海涌信投资发展中心(有限合伙)  | 境内非国有法人   | 1.72%                 | 11,164,040  | 0            |         |            |
| 上海明意文化传播事务所(普通合伙) | 境内非国有法人   | 1.43%                 | 9,270,000   | 0            |         |            |
| 杭州士兰微电子股份有限公司     | 境内非国有法人   | 1.11%                 | 7,200,000   | 0            |         |            |
| 杨国忠               | 境内自然人   | 0.89%                 | 5,800,008   | 0            |         |            |
| 北京乐文科技发展有限公司      | 境内非国有法人   | 0.41%                 | 2,661,504   | 0            |         |            |
| 李晖                | 境内自然人   | 0.36%                 | 2,352,000   | 0            |         |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明  | 前 10 名股东中,士兰微董事长陈向东担任杭州友旺的副董事长,士兰微的董事罗华兵担任杭州友旺的董事、总经理。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 |                       |             |              |         |            |

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(1) 概述

在全球经济形势持续低迷，电子整机国内市场需求不旺和出口市场连续波动的情况下，2012年中国集成电路市场在波动中逐渐企稳，并开始呈现出增长的发展态势。2012年上半年，受电子整机国内外消费需求低迷，市场未来前景不明企业纷纷消减库存等因素的影响，中国集成电路市场虽没有像全球市场那样出现衰退，但市场增速同样受到抑制，市场增速放缓至4.3%。2012年下半年，随着国家“节能惠民工程”政策的具体实施，一批大中型重点基础设施工程的批复和前期设备准备，以及移动互联网所带动的智能化设备渗透率的持续提高，中国集成电路市场在4月基本触底后，随之市场规模基本呈现逐月稳步扩大的增长态势。

2012年公司在多变的国际国内半导体市场环境下，按照“做精、做实、做强”的经营指导思想以及年度经营目标和战略规划，积极推进“集群突破、人才兴企”战略的深度实施，运用调结构、转方式、内引外联等灵活多便的管理创新模式和创新机制，在经营管理和生产运行过程中坚持“低成本、高效率、高质量、高服务、高产出”的原则。加大科技创新和工艺升级力度，提高铜制程能力，调整优化产品结构；积极改进销售策略，拓展海外市场，持续开展成本管控，使公司的管理能力和管控水平以及经营业绩显著提升。

2012年公司通过“集成电路高端封装测试生产线技术改造”项目和“集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造”项目的实施，使得公司的集成电路年封装能力由75亿块增加至80亿块，总资产达到25.55亿元，同比增长10.77%；本年度公司完成集成电路封装量68.88亿只，同比增长9.92%。

公司通过国家科技重大专项02专项、集成电路产业研究与开发专项等科技创新和技术研发项目的实施，开发出2圈、3圈VQFN68L、VQFN148L、VQFN256、UQFN68L、UQFN64L先进集成电路封装产品以及VSOP8L、LQFP176L等集成电路封装产品；完成了2圈VQFN100L、FCQFN68L、FCQFN12L、FCQFN156L、FCDFN6L、FCDFN8L、FCQFN10L、AAQFN256L、AAQFN128L的设计开发，部分产品通过了可靠性验证；开发出TFBGA/LFBGA/LGA系列集成电路先进封装产品14种，其中TFBGA445L、LFBGA144L、LFBGA441L产品实现批量生产；同时大力实施工艺优化和新材料导入，进一步优化和提高公司的集成电路封装制程工艺和技术水平。

2012年公司在加大集成电路先进封装技术和产品研发的同时，加强了人才的引进和培养工作，使公司的人才队伍不断充实和壮大，为公司今后的发展奠定了技术和人才基础。

## （2）主营业务分析

2012年公司主营业务为集成电路封装测试，全年实现营业收入16.23亿元，同比增长24.01%；归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，同比增长53.29%。变动原因为：

① 实现营业收入1,623,202,273.50元、发生营业成本1,316,972,151.95元，分别比上期同比增长24.01%和23.90%，主要原因是募集资金项目的进一步实施，扩大了公司的集成电路封装能力和产销量，公司的营业收入和营业成本较上期增加。

② 发生管理费用160,083,288.65元，比上期同比增长16.91%，主要原因是本期研发支出增加。

③ 发生财务费用21,587,031.07元, 比上期同比下降15.24%, 主要原因是利息支出较上年下降3.05%, 利息收入较上年增加53.88%, 6-10月美元价格较年初有所回升, 汇兑损益较年初下降92.16%。

④ 研发支出101,862,630.36元, 比上期同比增长27.54%, 主要原因是公司加大了国家科技重大专项02专项等科技创新和技术研发项目的实施力度, 新产品、新技术、新工艺开发支出增加。

### (3) 核心竞争力分析

#### ① 成本优势

公司地处西部地区具有较低的人力资源成本, 土地使用、生产动力等方面的价格也相对较低, 使公司具有国外以及国内沿海地区集成电路封装企业所无法比拟的成本优势。随着公司铜制程能力的不断提高以及成本管控措施的持续开展, 公司在成本方面的竞争优势将进一步得到加强和巩固。

#### ② 技术优势

公司依托国家级企业技术中心、甘肃省微电子工程技术研究中心、甘肃省微电子工程实验室等研发验证平台, 通过承担国家02科技重大专项等科技创新项目以及新产品、新技术、新工艺的不断研究开发, 自主研发出BGA、U/VQFN、FCQFN、AAQFN、MCM (MCP)、SiP、TSV等多项集成电路先进封装技术和产品, 随着公司进一步加大技术创新力度, 公司的技术竞争优势将不断突显。

#### ③ 市场优势

公司目前拥有1000多家客户的强大销售网络, 通过多年的合作, 公司得到了客户的广泛信赖, 为公司近几年的发展提供了有力的市场保证, 降低了市场风险。今后, 公司在稳定扩展国内市场的同时, 进一步加大海外市场的开发力度, 促进公司的持续快速发展。

#### ④ 管理团队优势

公司拥有一支善于经营、敢于管理、勇于开拓创新, 团结向上的经营管理团队; 公司法人治理结构完善, 各项管理制度齐全; 多年的大生产实践, 公司已形成了一套先进的大生产管理体系。

### (4) 公司未来发展的展望

#### ① 行业竞争格局和发展趋势

##### a、行业竞争格局

根据CCID发布的中国集成电路产业研究报告, 目前国内集成电路封装测试企业构成明显呈现外商独资、中外合资和内资三足鼎立的格局。其中, 由飞思卡尔、英特尔、松下、富士通、意法半导体、瑞萨、英飞凌等国际大型半导体企业在华投资设立的封装测试厂, 无论在

规模上还是在技术水平上都居主导地位，2012年，外商独资企业、中外合资企业已呈现出封装订单和产能向内地转移态势。近几年来，国内企业不断加大技术研发，在封装技术方面取得明显进展。未来，随着国内企业技术和管理水平的不断提高，国内企业的市场竞争能力将进一步提高，同时随着集成电路封装技术的不断发展和整机电子产品需求的不断变化，国内企业在技术、市场、品质和成本等诸多方面的竞争将更加激烈。

#### b、行业发展趋势

当前以移动互联网、三网融合、物联网、云计算、节能环保、高端装备为代表的战略性新兴产业快速发展，将成为继计算机、网络通信、消费电子之后，推动集成电路产业发展的新动力，我国集成电路市场也会继续成为全球最有活力和发展前景的市场区域。据中国半导体行业协会（CSIA）、中国电子信息产业发展研究院（CCID）预计，2012年~2014年，我国集成电路市场规模的年均增速超过9%，2014年达到10,617亿元；我国集成电路产业销售额的年均增速超过15%，2014年达到2,426.3亿元。据我国《集成电路产业“十二五”发展规划》，到“十二五”末，集成电路产业规模将再翻一番以上，集成电路产量超过1500亿块，销售收入达3,300亿元，年均增长18%，占世界集成电路市场份额的15%左右，满足国内近30%的市场需求。

#### ② 未来发展战略

公司将坚持以发展为主题，以科技创新为动力，以产品结构调整为主线，倡导管理创新、产品创新和服务创新，在扩大和提升现有集成电路封装业务规模与水平的同时，大力发展BGA、CSP、MCM（MCP）、SiP、FC、TSV、MEMS、LED等高端封装技术和产品，扩展公司业务领域，提升核心业务的技术含量与市场附加值，并积极向东部沿海地区拓展生产与业务网络，进一步开拓海外市场。在引进高层次管理技术人才的同时，将着力培养、打造一支在研发、经营、管理和销售方面具有竞争优势的高素质、业务娴熟的骨干队伍，以持续不断的技术和产品创新，提高企业的核心竞争力，并将公司发展成为国际知名的集成电路封装测试企业，打造中国封装测试行业的第一品牌。

#### ③ 2013年度生产经营计划

根据行业特点和市场预测，2013年度公司生产经营目标为全年实现营业收入19亿元，生产经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场需求、产品价格及客户经营状况等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

公司2013年主要开展以下工作：

继续实施“集成电路高端封装测试生产线技术改造”项目和“集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造”项目，不断扩大公司的集成电路封装能力，进一步提升集成电路铜制程封装能力。

加大科技创新投入，完善科技创新环境，继续实施国家科技重大专项02专项等项目，进行集成电路先进封测技术和产品的开发、工程验证以及产业化。

在稳定扩展国内市场的同时，进一步加大海外市场的开发力度，促进公司的持续快速发

展。

#### (5) 公司战略实施和经营目标达成所面临的风险

##### ① 受半导体行业景气状况影响的风险

公司所处行业受半导体行业的景气状况影响较大，半导体行业是周期性行业，公司经营状况与半导体行业的周期特征紧密相关，半导体行业发展过程中的波动将使公司面临一定的行业经营风险。

##### ② 主要原材料价格波动的风险

公司产品主要原材料包括金丝、引线框架和塑粉，这三种原材料价格变化对公司经营业绩影响较大；塑粉的价格相对比较稳定，金丝的材料是黄金，引线框架的主要材料是铜，因此这两种原材料的价格与黄金、铜的价格走势密切相关。如果黄金与铜的价格变化存在较大的波动，从而会导致公司经营业绩出现一定的波动。

针对上述风险，公司未来将紧跟半导体行业技术发展趋势，加大集成电路先进封装技术的研发和产业化，扩大营销网络，分散和化解市场风险。同时，不断提高铜制程集成电路封装能力，持续开展新工艺、新技术的应用和流程优化以及节能降耗，降低经营成本，提高公司的盈利能力和抗风险能力。

#### 4、涉及财务报告的相关事项

##### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

##### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

##### (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围。

2012年5月10日，本公司与甘肃省核地质二一九大队签署《组建天水中核华天矿业有限公司合作协议书》，双方同意合资设立天水中核华天矿业有限公司。矿业公司注册地址在甘肃省天水市，注册资本1,000万元，其中本公司以货币出资700万元，占注册资本的70%，2012年6月矿业公司成立，矿业公司属公司控股子公司，本期将纳入公司合并财务报表的合并范围。

##### (4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

天水华天科技股份有限公司

法定代表人：肖胜利

二〇一三年三月十四日